

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台 79-1

「第37回独創性を拓く 先端技術大賞」 経済産業大臣賞を受賞

産経新聞社が主催する「第37回 独創性を拓く 先端技術大賞」において、国立大学法人横浜国立大学（以下「横浜国立大学」）、株式会社ディスコ（以下「ディスコ」）、東レエンジニアリング株式会社（以下「東レエンジ」）は、『ハイブリッド接合の開発と省電力チップレット集積技術への適用』のテーマで、社会人部門の最優秀賞である「経済産業大臣賞」を受賞しました。

現在、社会における処理データの爆発的な増加で半導体には、計算量の更なる増加に対応する高性能化と、消費電力を抑える一層の省エネ化に加えて、高性能半導体デバイスの普及を可能にする低コスト化の実現が求められています。

これらの課題に対して、従来半導体の集積に使用されることが一般的な接着剤とスズを使用しない「ハイブリッド接合」技術の開発に、横浜国立大学とディスコ、東レエンジが共同して取り組んでいます。

今回は、横浜国立大学の新たなチップ集積手法の確立とメカニズムの解明、ディスコのパーティクルレスなブレードダイシング技術の開発、東レエンジの接合表面を非接触でウエハーからダイのピックアップや反転が可能な搬送システムの実現が評価されました。

横浜国立大学 半導体・量子集積エレクトロニクス研究センターでは、DX（デジタルトランスフォーメーション）とGX（グリーントランスフォーメーション）の両立の実現により、社会に貢献してまいります。



7月23日に東京・元赤坂の明治記念館で開かれた受賞式の様子

<参考資料>

先端技術大賞受賞 内容紹介および受賞論文

<https://www.sankei-award.jp/sentan/jusyou/>

本件に関するお問い合わせ先

横浜国立大学 総務企画部 リレーション推進課 E-mail: press@ynu.ac.jp